

更
2017 技 受



更 2018 4 19
 13:30-14:30 亏 e
<http://sns.sseinfo.com> e 受 技 2017
 技 亏 受
 受
 2018 4 14 受 技
 2018 4 19 临
 技 技
 亏 更 技
 技
 1 技 券 更享
 2017 括 可
 互 5G /
 HPC MEMS / 广 10nm
 互 HD FOWLP eWLB
 互 ECP 互 3D SiP 严
 更 严 广 互
 SiP FOWLP eWLB ECP Flip Chip
 /
 2 技 2017 万 严 3.43
 号 222.89% 3,399.61

享
 立
 从
 括 局 技
 万括
 括 局 互
 互 技 万
 3 技 局 互 享
 SIA 2017 4,122
 2016 21.6% 35.0% 17.1%
 16.4% 13.3% 22.2%
 区 2017 互 严 5,411.3 号
 24.8% 2017 号 28.5%
 创 1,448.1 括 严 26.1%
 20.8% 严 2,073.5 1,889.7
 互 审 互 局
 开 审 互 技 严
 开 2017 互
 号 21.6% 互 号 24.8%
 互 34.92% 局 严 局
 4 技 14nm
 12 14nm bumping 创 FC
 券 互
 5 技 18
 严享 创 更 券
 券 亏 广
 券 么

2018 4 28 2018

6 技 2015 2016 享

参

2015 2016

严

券

创

局

创

封

广

更

7 技

更

2014

2013

广

向

2014

2013

互

2016 1

16

亏

更

STATS ChipPAC Ltd.

2015

7

31

2014

2013

完

更

2014

2015

7

31

8 技

2018

更享

2018

严

258

互

2018

向

区号 广

严

1

严 2

严

3

分

号 局 4 互

互

5

排

9 技

更 创

享

券

创

创

10 技 更

审

严

互

11 技 2017

2017 括

238 号 24.54% 万 3.43 号

222.89%

12 技

IC Insights 2017

券 10 司

13 技

2015 1

排 排 可

BU SCK SCS JSCC 互 严

KPI 可 BU

2 互 互

更 券 开

互

局 互 局

号互 可

区号 互 SCK -

FCCSP+POP + SiP 严 SCS

eWLB Fan-Out +WLP 互

JSCC 号 万 Bumping

创 互 Wirebond 互 3

互 导

互

互

4 SCC

JSCC

SCC

2015

-2017

9

2017 9

JSCC 券

FC

JSCC

互

互

广

2017

JSCC

2017

创

9,462.16

券

JSCC

2017

2016

JSCC SCC

号

35.60%

2017

91.55%

更

2017

技

亏

e

<http://sns.sseinfo.com>

e

可 技

技

括

局 技

更

2018 4 19